



H6201 导热粘合剂

H6201 是一种单组份，可流动，高强度的热固化型导热粘合剂。应用于倒装芯片的封装中，将封装盖板粘结于有机基板表面，增加封装盖板与有机基板的连接强度，提高芯片整体可靠性；同时为 TIM1 和 ECU 芯片封装冷却提供有效的热传导。

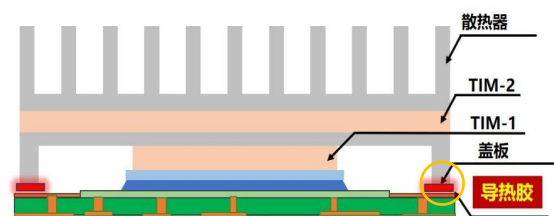
产品描述

产品特征

条目	描述
技术类型	有机硅
外观	灰色膏状
典型应用	倒装芯片FC-BGA封装 (CPU,GPU) 新能源汽车ECU 其他电子设备，用于冷却电子元件，延长使用期，有助于将现场使用的科学仪器和军事设备保持恒定温度。

产品优点:

- 高粘接强度
- 良好的可操作性（适合低粘度点胶工艺）
- 导热性能佳
- 低的挥发量
- 高绝缘性能
- 对金属，陶瓷，PCB 等基材具备优良的附着力



产品性能

条目	典型值	备注
固化前		
粘度(Pa.s@5s ⁻¹)	82	ASTM D2196
固化 (125°C/90min) 后		
硬度 (Shore A)	89	ASTM D2240
比重	2.79	ASTM D792
导热系数 (w/m.k)	1.75	ASTM D5470
拉伸强度 (MPa)	5.7	ASTM D412
断裂伸长率 (%)	37	ASTM D412



剪切强度 (MPa)	5.0	ASTM D1002 Cu/Cu
击穿强度 (kv/mm)	45	ASTM D149
体积电阻率 ($\Omega\cdot\text{cm}$)	$\geq 1 \times 10^{11}$	ASTM D257

使用指南

从冷冻状态下取出，放置 2 小时恢复至室温。使用自动点胶机点胶时，设置好出胶量及点胶路径施胶到发热源元件面上，然后与散热元件压合好按标准固化条件 125°C/90min 完全固化即可，若需要返修或多余的胶料可以用无尘布轻易擦掉。

标准包装

- 30ml/支
- 根据客户要求

产品储存

本产品无毒性、无危险性，遵循标准化学品运输和储存。

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

储存温度：-10°C低温冷冻保存，有效存储期为 6 个月。

为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在所述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com